

データ処理高効率化と省エネルギー化を目指した

半導体チップレット集積と ハイブリッド接合技術の 研究動向と課題

令和7年9月5日(金)13:00-17:00

※16:30-17:00 名刺交換会

講師

井上 史大 氏

(横浜国立大学
大学院工学研究院 准教授)

定員

50名

会場

かながわサイエンスパーク
講義室

受講料

15,000円(税込)

爆発的に拡大するAI需要を背景に、半導体にはデータ処理の高効率化と省エネルギー化がこれまで以上に強く求められています。こうした課題のブレークスルー技術として、近年「チップレット」が大きな注目を集めています。特に、超高密度配線を実現する「ハイブリッド接合」は、次世代AIアーキテクチャに不可欠なキーテクノロジーと位置づけられています。本講座では、ハイブリッド接合技術の最前線の研究開発動向と今後の課題について詳しく解説します。

カリキュラム

13:00-14:30 (90min.) 「チップレット集積の基礎」

14:40-16:10 (90min.) 「ハイブリッド接合の研究動向と課題」

16:10-16:30 (20min.) 質疑応答

※終了後、16:30より30分間の名刺交換会を設けております。

対象

- ・ チップレット技術やハイブリッド接合技術を活用した新しい設計手法を学びたい方
- ・ 高精度なD2W接合の利点と課題について学び、今後の研究開発の参考としたい方
- ・ ハイブリッド接合技術を可能とする製造プロセスや装置に関心のある方
- ・ 製造工程における要素技術や地域の産業集積に関する情報を収集したい方

お申し込み方法

KISTECホームページより、「講座・研修」をクリック、
本講座のページからお申し込みください。

講座お申し込み

主催(地独)神奈川県立産業技術総合研究所

申込要領

- HP (<https://www.kistec.jp/learn>)よりお申込みいただけます。
- 申込締切後でも、定員に余裕がある場合はお申込み受付可能な場合がございますのでお問合せください。
- 受講資格はお申込みをいただいた方 (1 申込 1 名)に限ります。
- 講義中、許可なく講義内容の一部、およびすべてを複製、転載または撮影、配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。
- やむを得ない事情により、日程・内容等の変更や中止をする場合があります。
- その他、お申込みについてご不明な点は、お問い合わせください。

お申込み方法

<https://www.kistec.jp/learn> または
KISTEC HPトップページ > 講座・研修 > 研究者・技術者向け



講座お申し込み

- KISTEC教育講座「研究者・技術者向け」ホームページ、または下記申込書よりお申込み下さい。
- ホームページからのお申込みでご不明な点がございましたら、メールまたはお電話でお問い合わせください。



KISTEC
教育講座

個人情報の利用及び提供の制限

- 申込書にご記入いただいた個人情報は、当所の事業等に関する情報や参加者募集の案内などの範囲内で利用または提供いたします。個人情報は、取扱目的以外に利用したり、第三者に提供することはありません。



地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)

人材育成部 教育研修グループ

E-mail : manabi@kistec.jp Tel: 044-819-2033

フリガナ 氏名		太枠内は必須項目です。必ずご記入のご確認をお願い申し上げます。*の項目は、該当するものに○・☑を付けてください。	
フリガナ 企業名			* この講座のご案内はどこでご覧になりましたか ダイレクトメール(郵送) メールマガジン(KISTEC発行 / 学会や関連団体) 雑誌・会報等 チラシ ポスター KISTECホームページ 学会や関連団体のホームページ 講師から 上司から 受講生から その他()
住所	〒 -		* 今後、KISTECからの情報をお送りしてよろしいですか 郵送 : 要・不要 / メールマガジン : 要・不要
所属			* 資本金
役職			* 従業員数
TEL・FAX	TEL / FAX	* 性別 男・女 * 年代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上	